

## SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



モジュラーエレクトロニクスハウジングシステム対応の統合レールバス

モジュラーアプリケーションで供給、接続、分配を行う場合、レールバスは複雑な個別配線プロセスを細線仕様で中断のない、広範なシステムソリューションに置き換えることができます。

システムバスは 35 mm 径の標準取り付けレールの中にしっかりと組み込まれています。SMD バス接点ブロックは、リフローはんだ付けが可能なため、コンポーネント組み立て時に完全自動で処理することができます。耐久性を有する金メッキ接触表面は、あらゆるハウジングの幅に対応し、永続的で信頼性の高い接続を保証します。

- 無制限の拡張性 統合接続ソリューションは、6 mm スライスから 67 mm 大容量ハウジングまで、すべてのシステムの幅を対象とします。
- 設置時の管理が容易 既存のモジュールグループ内でも、モジュールを簡単に交換でき、隣接するモジュールに影響を与えることはありません。
- 総合的な統合 非絶縁システムバスは 35 mm 径の標準取り付けレールの中にしっかりと組み込まれています。
- 最大限の可用性 5 点の完全な垂鉛メッキおよび部分的に金メッキされたツイン円弧接点を使用して、レールバスへの常時接続を確立します。THR はんだフランジは、回路基板への接続安定性を確保します。

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, CH20M6用バス接点ブロック, THT/THRはんだ接続, 極数: 5, 180°, 金メッキ, 黒色
注文番号	<a href="#">1155840000</a>
種別	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX
GTIN (EAN)	4032248942534
数量	78 Stück
製品データ	IEC: 160 V UL: 300 V / 5 A
パッケージ	箱

## SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	5.9 mm	高さ (インチ)	0.232 inch
幅	16.3 mm	幅 (インチ)	0.642 inch
長さ	24 mm	長さ (インチ)	0.945 inch
正味重量	2.897 g		


## 材料データ

絶縁材	LCP	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	$175 \leq CTI < 400$	絶縁耐性	$\geq 10^8 \Omega$
Moisture Level (MSL)	1	接触表面	金メッキ
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-30 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

## IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	3.6 A
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	160 V	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	100 V
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	63 V	短時間耐電流抵抗	3 x 1s with 14.5 A
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 II/3	1.5 kV	クリアランス、最小	2.3 mm
沿面距離、最小	3.2 mm		

## UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)		証明書番号 (cURus)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)	50 V
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	50 V	定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	5 A
定格電圧 (使用グループ C/UL 1059)	5 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	5 A
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

## 材質データ

比較追跡指数 (CTI)	$175 \leq CTI < 400$	絶縁材	LCP
絶縁材グループ	IIIa		

## 一般データ

カラーチャート (類似)	RAL 9011	保護度合い	IP20がインストール済み
色	黒色		

## 分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-18-27-92

作成日 2024/07/04 6:34:31 CEST

## SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

## 重要なメモ

IPC準拠

適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

## 承認

認可



ROHS

適合

UL File Number Search

UL ウェブサイト

証明書番号 (cURus)

E60693

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

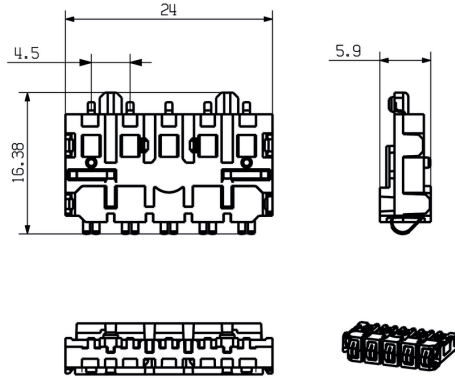
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

**SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

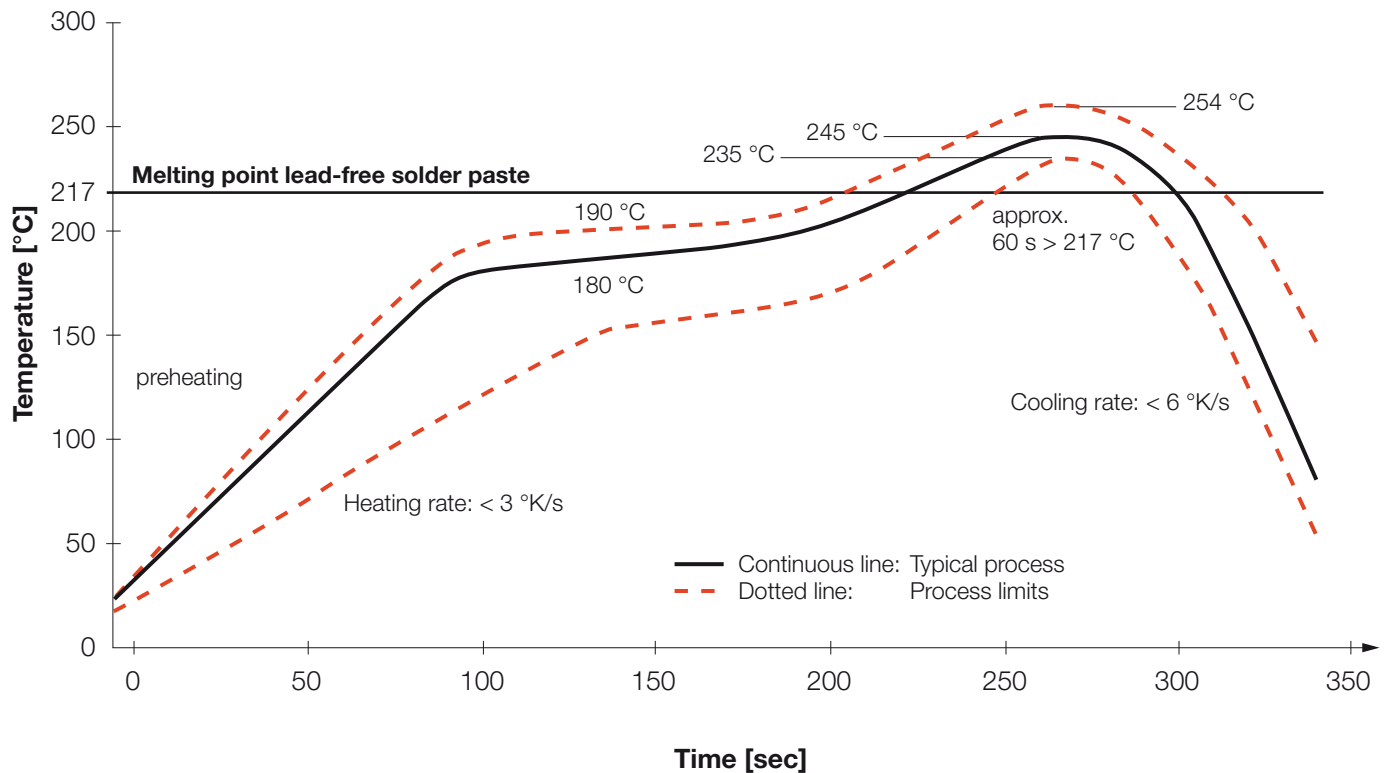
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



### Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.